# 國立虎尾科技大學機械設計工程系 113 學年度『機械工程實驗(二):熱流力實驗』

# 實驗 6. 真空抽氣性能實驗報告

指 導 教 授: 周榮源

班級:四設計四甲

組 別:第五組

組 員: 41023112 王啟騰

41023121 李承翰

41023134 林建維

41023146 洪偉陞

41023147 紀閔翔

# 實驗六. 真空抽氣性能實驗

### 壹. 實驗目的

本實驗旨在深入研究真空系統的運行特性,通過真空幫浦 的性能測試,了解真空腔體內的壓力變化過程以及各種影響因 素。本實驗的核心任務包括評估真空幫浦的抽氣速率、終極壓 力以及系統的氣導效能,並探討壓力變化曲線與抽氣效率之間 的關係。

在實驗過程中,首先組裝真空系統,並進行密封性檢測,確保真空腔體及管路系統無洩漏問題。通過逐步降低系統內壓力,記錄壓力下降過程中的數據,並繪製壓力下降曲線(Pump Down Curve)。此外,實驗會調整角閥和洩氣閥的開度,研究系統在不同條件下的抽氣和洩氣性能,並利用這些數據計算等效氣導(Conductance)。這些測試不僅幫助理解系統內壓力變化的動態過程,也有助於評估不同條件下的最佳操作參數。

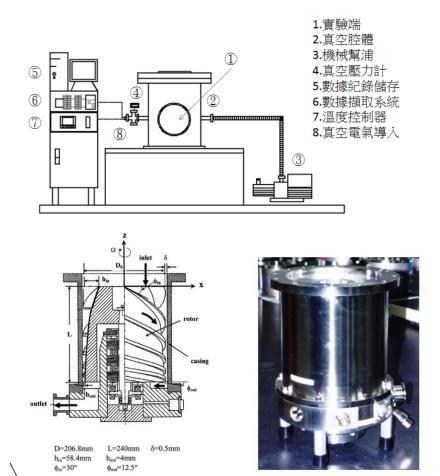
實驗的另一重點是分析真空幫浦的性能指標,包括抽氣速率的穩定性和達到終極壓力所需的時間。這些數據可以用來比較不同類型真空幫浦的性能優劣,從而為選擇適合特定應用的幫浦提供參考。

實驗結果具有廣泛的應用價值,例如在半導體製造、光電

產業和科學研究中的真空技術設計與優化。特別是,這些數據 可用於提高真空乾燥、薄膜沉積和氣相製程等操作的效率與精 確性。同時,透過本實驗,參與者能更加系統性地掌握真空技 術的基本原理,理解壓力、體積與流速之間的數學關係,並運 用於實際工程設計中。

總體來說,此實驗不僅是一次性能測試,更是一個學習和 理解真空技術在高科技應用中關鍵作用的過程,對於真空系統 的優化與創新設計具有重要意義

# 貳. 儀器與設備

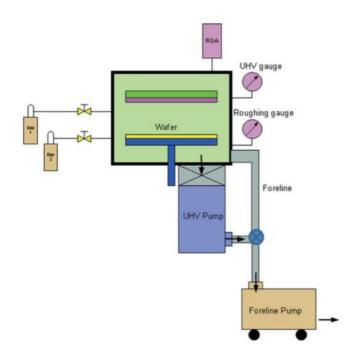


1	實驗端
2	真空腔體
3	機械幫浦
4	真空壓力計
5	數據紀錄儲存
6	數據擷取系統
7	温度控制器
8	真空電器導入

## 參. 實驗原理

#### (一)真空幫浦抽氣原理

真空幫浦之功能是將一特定空間之氣體抽除,使氣體密度降 低,達到某一壓力狀態。但 是,氣體在真空系統中之流動特性隨壓 力之不同而有很大差異,如表 1 所示。因此,對不同 壓力範圍必 須依相對應之抽氣原理來設計不同型態幫浦。同時,針對特定抽氣 要求, 需組合 搭配不同性能與型態之真空幫浦來使用, 才能達到有 效又經濟之真空抽氣目的。圖 1 所示為 一真空系統基本架構,主 要包括真空腔體、真空幫浦 ( 粗抽幫浦及高真空幫浦 )、真空計、 抽 氣管路系統及壓力調節功能 ( 製程氣體供氣、清洗、壓力控 制 ) 等。 真空幫浦之抽氣速率 (Pumping Speed) 係指幫浦進氣口 處之容積流率大小,其單位為 L/s, m3 /hr 等型式。在穩定抽氣狀 態時,可由氣流通量(Throughput)Q 及壓力 P 來決定,亦即 S = Q/P。單位時間內通過一導通面積單元之氣體質量稱為質量流率 (Mass Flow Rate),事實上與 氣流通量具有相同物理意義,但在真 空技術中常以壓力及體積之乘積 PV 值,間接表示氣體 總質量 G。 真空幫浦之抽氣量即進氣口處之氣流通量,其單位是 Torr·L/s。 如果進氣口壓力為 定值,則氣流通量可寫成 Q = P × S。真空幫浦 之抽氣量不同於抽氣速率, Q 之大小較具實際



物理意義:氣體密度高時,壓力大,若密度與溫度為定值,則 Q 與 S 成正比;但是,在高真空狀態下,氣體密度很稀薄,此時 Q 之大小較能表示真空幫浦真正性能,抽氣速率本身並不 足以完整顯示真空抽氣系統之工作效能。 另一個常見的真空系統名詞為氣導 (Conductance, C),氣導之特性包含:

- (1) 其單位與抽氣速率相同;
- (2) 氣導大小決定於管路幾何形狀及氣壓;
- (3) 真空度高時,氣導與壓力無關。在中低真空度時,與壓力有密切關聯;
- (4) 由於真空系統中有許多孔、閥、管…等元件,會造成氣導降低,因此真空幫浦實際有效抽 氣速率 (Seff) 可由下式求得

$$\frac{1}{S_{eff}} = \frac{1}{S_o} + \frac{1}{C}$$

氣導大小可由 Q = C(P1-P2) 關係式求得,在相同壓差下, 氣流通量與氣導成正比。所以, 參考表 1 中氣導的計算式可 知,選擇真空管路之原則是長度 (L) 要短,直徑 (D) 要大。

#### 表 1 真空氣流分類:

氣流種類	氣壓範圍	紐森數 Kn	氣導 C
黏滯流 (Viscous)	760~0.75 Torr (P≅760 Torr : 紊流 P≅9 Torr : 層流)	Kn < 0.01 (Re>2200:紊流 Re<2200:層流)	$C = 136.5 \frac{D^4 P}{L}$
過渡流 (Transition)	0.75~ 10 <sup>-3</sup> Torr	1 > Kn > 0.01	$C = \frac{D^3}{L} \left[ 136.5DP + 12.1 \left( \frac{1 + 192DP}{1 + 273DP} \right) \right]$
分子流 (Molecular)	10⁻³∼ Torr	Kn > 1	$C = 12.1 \frac{D^3}{L}$

## 肆.實驗項目

#### 1. 真空系統組裝:

- (1)以擦拭紙沾酒精將所有0-ring及封合面清潔乾淨,並檢察有無損傷。
- (2)依照示意圖與實體圖將所有KF25接頭包括0-ring鎖緊(要對準不可太 用力,避免將0-ring壓傷),完成真空系統組裝。

#### 2. 簡易測漏方法:

- (1)開啟真空幫浦,並注意真空計之讀值,若壓力一直無法下降,則立刻關閉真空幫浦電源。
- (2)檢查各個接頭有無確實鎖好,必要時拆開接頭重新鎖緊。
- (3)當真空幫浦能順暢運作後,觀察真空計之讀值能一直往下降,表示 抽真空功能正常。
- (4)關閉真空幫浦電源準備進行後續實驗。

#### 3. 真空壓力量測:

- (1)將真空幫浦進氣口位置之NW25 Angle valve開度調整為1/4。注意Vent valve是否確實關緊。
- (2)準備好可以計時之計時器,啟動真空幫浦,每5秒紀錄真空計之 壓力讀數與時間,總計錄時間為10分鐘。
- (3)重複(2)之動作,直到讀數不再變化(約20分鐘後達到穩態後)為 止。記錄下最後壓力讀數,此為終極壓力。
- (4)將真空幫浦關閉,接著打開Vent valve讓腔體內外壓力達到平衡 為止。此時真空計讀數應為latm(760Torr)左右。
- (5)調整NW25 Angle valve開度調整為其他開度,並重複上述步驟進 行實驗。注意Vent valve是否確實關緊。
- (6)完成後關閉真空幫浦,接著打開Vent valve讓腔體內外壓力達到 平衡為止。

#### 4. Venting實驗:

- (1)將真空幫浦進氣口位置之NW25 Angle valve開度調整為全開。注意Vent valve是否確實關緊。
- (2)啟動真空幫浦,將腔體壓力抽至終極壓力(應與上一實驗一致)。
- (3)將NW25 Angle valve關閉,接著關掉真空幫浦。將Vent valve開 度調整為1/4,每5秒紀錄真空計之壓

力讀數與時間,直到讀數不再變化(達到穩態後)為止。

(4)將Vent valve關閉,接著將NW25 Angle valve全開,之後將真空 幫浦打開,將腔體壓力抽至終極壓力

(應與上一實驗一致)。

- (5)重複(3)-(4)動作,完成其他調整Vent valve開度調整。
- (6)完成後關閉真空幫浦,接著打開Vent valve讓腔體內外壓力達到 平衡為止。